



会期：2016年4月20日(水)～22日(金)

会場：札幌市教育文化会館

主催：エレクトロニクス実装学会(JIEP) 共催：IEEE CPMT Society Japan Chapter, IMAPS

[口頭発表] 表言語は英語です。エレクトロニクス実装学会の規程によりベストペーパー賞が授与されます。
また、IEEE CPMT Society Japan Chapterの規定により、35歳未満の方を対象にヤングアワードが授与されます。
[ポスター発表] 発表言語は英語です。エレクトロニクス実装学会の規程によりポスター賞が授与されます。

論文募集分野(Session名及びKeywords)

1. Advanced Packaging

Wafer Level Packaging, System Integration, PoP, MCM, System on Package, Novel Assembly Technologies

2. Substrates and Interposers

Laminates, Interposers, Fine Pitch, Build-Up Substrates, Flexible Printed Circuits, Embedded, Conductive Paste, Thin Core, Coreless, Low CTE

3. Interconnection

Bump Formation, Chip-Package Interaction, Low k, Leadframe, Test of First- and Second- Level Interconnections, Interconnections for 3D Integration, Interconnections in Substrates, PCBs and Systems

4. 3DIC Packaging

TSV, Via Formation and Filling, 2.5D, Wafer Thinning, Silicon Stacking, Chip on Chip, Chip on Wafer, Wafer on Wafer, Wide Bus, Wireless Interconnection, Temporary Bonding/De-Bonding

5. Design, Modeling, and Reliability

Signal and Power Integrity, High-Speed Board Design, Mechanical Design and Reliability, Failure Analysis, Fracture and Warpage in Packages, Testing, Evaluation, TCAD, 3DIC Design

6. Thermal Management

Advanced Cooling Modules, Heat Pipes, Heat Sinks, Fans and Blowers, Thermal Interface Materials, Thermal Measurements, Micro and Nano Scale Heat Transfer, Thermal Issues in Devices

7. Materials and Processes

Novel Materials and Processing, Dielectrics, Emerging Materials and Processes for 3D, Thin Films, Underfills, Assembly Challenges and Solutions, Wafer Thinning, Plating, Equipment, Encapsulation

8. Printed Electronics

Inkjet, Screen Printing, Conductive Wiring, Insulation, Printed Organic TFTs, Device Applications

9. N-MEMS

NEMS-MEMS/Sensor Devices, MOEMS, Assembly and Packaging, Nano Technology, Nano Imprint Lithography, Organic Semiconductors, Wireless Sensor Networks

10. Optoelectronics

Active Optical Cable, Photonic Devices, Optical Fibers, Waveguides, Optical Interconnects, Transceivers, Connectors, LD/PD, LED, OE/EO, TOSA/ROSA, WDM, Optical Wiring Boards

11. Self-Organization/Self-Assembly

Biomimetics, Nature-Guided, Bottom-Up Manufacturing, Smart Materials and Devices, Spontaneous Ordering/Patterning/Structuring, Self-Bonding/Debonding, Repairable, Self-Healing, Novel Micro/ Nano Processing

12. Medical Devices

Invasive, Low Invasive, Non Invasive, In Vitro, BAN, Cure, Treatment, Diagnosis, Screening, POC, Healthcare

13. Power Electronics Integration

Si, SiC or GaN Power Device/Module Packaging and Reliability; Packaging of High-temperature Power Electronics, Sensors; Inverters/Converters for Electric Vehicles; Magnetic Materials and Components; PE Substrate Technologies; PE Encapsulation Materials; PE Integration by 3D Printing

14. RF

RFID, High Frequency Devices, Packaging, Filters, EMI, EMC, Antennas, Wireless Power Transmission

15. Others

Market Trends, Environmentally Conscious Products and Processes, Cost Analyses

会議情報

発表者参加費 (ポスター発表の方も必要です。)

- ・ 会員 41,000円(論文集、Reception、消費税を含む)
- ・ 非会員 55,000円(論文集、Reception、消費税を含む)
- ・ 学生 12,000円(論文集、消費税を含む)

※JIEP, IEEE, iMAPSにご入会いただけますと、会員価格が適応できます。

組織委員会

委員長：水野 潤(早稲田大学)

副委員長：植垣 祥司(ASE Group)

野上 義生(東レエンジニアリング)

横内 貴志男(富士通イターコネクトテクノロジーズ)

お問い合わせ

ICEP2016組織委員会事務局(エレクトロニクス実装学会)

TEL：03-5310-2010

E-mail: icep2016@jiep.or.jp

URL: <http://www.jiep.or.jp/icep/>

アブストラクト・本論文の締切

アブストラクトの締切：2015年10月31日

アブストラクトは英文300ワード以内です。図、表、写真はいずれか1点の貼付が望ましいです。登録方法はホームページに掲載いたします。

<http://www.jiep.or.jp/icep/>

採否通知：2015年12月中旬

採否の通知はEメールでお送りします。

本論文提出期限：2016年2月20日

本論文は、4から6ページです。ポスター発表の方も論文を執筆してください。

本論文は、プロシーディングのほか、IEEE Xploreにも掲載されます。「執筆要領」はHPに掲載します。